



玉山投顧
E.SUN Investment Consulting

研究報告

天虹(6937.TT)

買進(初次)

目標價：320.0

營運走出谷底，產品組合優化帶動毛利回升

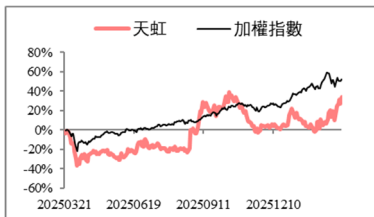
核心觀點

營運谷底已過，先進封裝在未來取代化合物半導體成為最大營收動能，2027年設備業務營收占比過半。

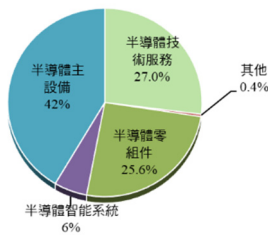
交易資料

收盤價	248.00
市值(億元)	167.60
流通在外股數(百萬股)	67.58
本益比(2026F)	38.74
股價淨值比(2026F)	4.72
240日股價(低/均/高)	157.5/223.5/292
60日均成交額(百萬元)	168.18

相對報酬率



2026年營收比重預估



CSR 天下永續公民獎

企業類別	2024 排名	2023 排名	平均總分	公司治理	企業承諾	社會參與	環境永續
-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：天下雜誌

2024 年公司治理評鑑

項目一	評鑑結果排名
上市公司	36%至 50%
項目二	評鑑結果排名
市值 100 億元以上之電子類	41%至 60%

資料來源：證基會

研究員：李尚威

troy-2243@esunsec.com.tw

玉山觀點

2025年第三類半導體逆風導致設備出貨放緩，零組件業支撐營運：

2025年半導體客製化零組件業務營收年增20%，主要受惠於各大晶圓代工與記憶體廠產能利用率維持高檔，但第三類半導體客戶資本支出放緩，全年設備總出貨量降至25台(2024年出貨35台)，2025年營收22.4億元，YoY-13.2%，受營收規模縮減及設備佔比降低影響，毛利率下滑至40.1%，稅後EPS由2024年的6.03元下降至3.01元。

2026年設備營收超越2024年，產品組合優化帶動毛利率回升：

2026年成長動能來自：(1)預估光電設備營收有望翻倍：受惠光通訊與CPO設備需求強勁，2026年光電設備營收有望翻倍(ALD與PVD設備應用於高精度度光學與絕緣層鍍膜)。(2)CoPoS設備為未來最具潛力的核心動能：天虹成功開發310mm x 310mm規格的PLP PVD與Descum設備，其PLP PVD已於2026年1月出貨並在OSAT廠進行正背面金屬導線鍍膜的驗證，PLP Descum設備則是正在天虹廠內進行認證中。(3)半導體零組件業務維持高雙位數強勁成長：零組件與技術服務為天虹最穩定的業務，受惠晶圓廠產能利用率極高帶動耗材需求，以及每年持續開發數十樣客製化新品，預估2026年零組件營收可維持約20%的強勁增長。(4)2026年設備營收超越2024年，2027年設備營收占比過半：預估封測產品線有望在未來取代化合物半導體成為最大營收來源，帶動設備產品線營收占比過半，達成營收結構的戰略性轉型。

投資建議

預估天虹2026年營收年增35%至30.3億元，稅後EPS 6.4元，公司過往Forward PER落在40~60倍，目前PER 38.7評價落在下緣區間，考量半導體零組件維持強勁成長動能加上設備業務回溫，故給予PER 50倍。主要風險為先進封裝擴產放緩而衝擊營運。

圖表1、簡易損益表

(單位：百萬元)

	2025	26Q1	26Q2	26Q3	26Q4	2026(F)
營收	2,245	582	613	824	1,011	3,030
YoY	-13.3%	26.3%	19.6%	49.9%	40.1%	35.0%
毛利率	40.1%	40.7%	41.9%	43.7%	44.3%	43.0%
營益率	8.6%	11.5%	10.9%	17.6%	21.6%	16.4%
稅後淨利	203	69	63	122	179	433
EPS(元)	3.01	1.02	0.93	1.81	2.64	6.40

公司簡介

天虹(6937)為台灣首家成功開發自製物理氣相沉積(PVD)與原子層沉積(ALD)設備之供應商，核心業務聚焦於半導體自製設備、零組件耗材維修及代理產品。公司總部設於台灣新竹，主要生產基地位於台灣竹北總部、湖口廠、竹北新廠、南科廠、中國廈門廠。2025年營收比重為半導體技術服務31.8%、半導體主設備31%、半導體客製化零組件29.4%、半導體智能系統7.3%、其他0.5%。主要客戶包括台積電、聯電、日月光、矽品、晶電、鴻揚半導體等等。2025年銷售地區比重為台灣60.1%、中國28.9%、新加坡9.1%、其他1.9%。

天虹初期以半導體耗材與設備維修起家，2017年起跨足自有品牌設備，專注於開發高真空電漿技術，產品涵蓋PVD、ALD、Bonder/Debonder、Descum及EUV光罩保護膜(Pellicle)檢測設備，主力設備為PVD跟ALD。PVD(Physical Vapor Deposition,物理氣相沉積)是在真空環境下，利用物理能量(例如加熱或離子撞擊)將靶材變成氣態原子，並在晶圓表面沉積形成薄膜的技術，天虹的PVD設備主要應用於金屬層的鍍膜與製作導線，沉積超過20幾種與導體相關的薄膜。ALD(Atomic layer deposition, 原子層沉積)是化學氣相沉積的一個子類，將物質以單原子膜形式一層一層地鍍在晶圓表面，是化學氣相沉積的一個子類，天虹的ALD設備提供10幾種絕緣層、保護層與少部分的導體(鉬)。除了整機設備，天虹具備強大的關鍵零組件開發能力，提供陶瓷零件、石英類零件、金屬類零件、真空傳動件、電控零件等兩千多種產品。

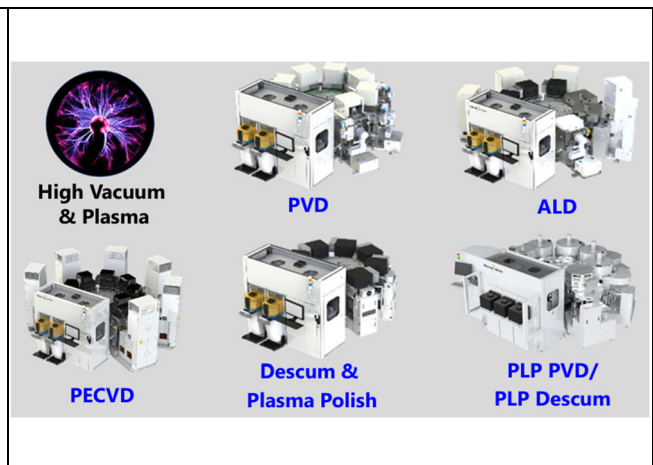
天虹初期避開國際大廠壟斷之矽基半導體前段設備，專注於化合物半導體領域，藉由晶電切入用於蘋果Mini LED產品的ALD設備，直到2024年化合物半導體領域設備營收佔比仍逾50%。由於2017年才轉型自有品牌設備研發，錯過2013年起步之CoWoS設備研發，因此天虹將研發重心鎖定在下一代CoPoS封裝技術，領先業界推出310mm x 310mm規格的PLP PVD與Descum設備，封測產品線有望在未來取代化合物半導體成為最大營收來源，達成營收結構的戰略性轉型。

圖表2、天虹設備營收比重

產品比重	2024	2025	2026(F)
PVD	61.7%	59.2%	68.8%
ALD	23.1%	31.9%	23.6%
BD/DB	11.1%	3.3%	3.5%
Etch	4.2%	5.6%	4.2%
產業比重	2024	2025	2026(F)
矽基半導體	15.3%	12.5%	8.3%
封裝	19.4%	38.1%	43.1%
化合物	55.6%	34.2%	29.2%
光電	9.7%	15.3%	19.4%

資料來源：天虹、玉山投顧整理(2026/04)

圖表3、清洗製程示意圖



營運概況

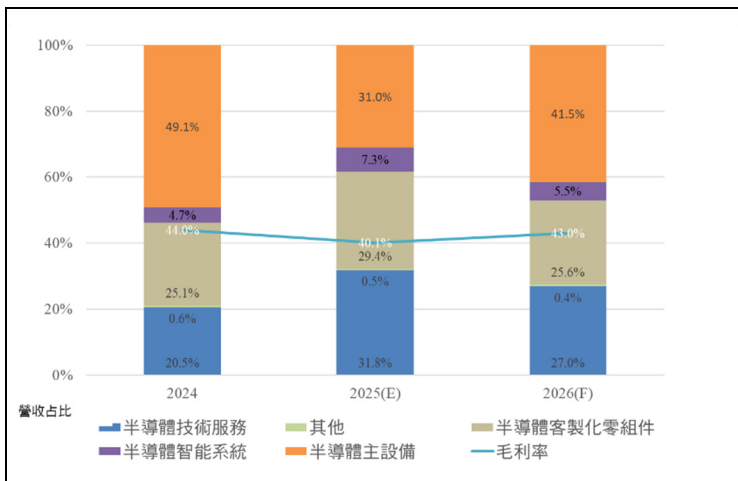
2025年第三類半導體產業逆風導致設備出貨放緩，零組件業支撐營運：受惠於過去幾年化合物半導體的高速成長，天虹在2024年交出亮眼成績，但2025年面臨第三類半導體客戶資本支出放緩，全年設備總出貨量降至25台(2024年出貨35台)，營收減少加上產品組合的改變(設備營收比重降低)，使得2025年毛利率下滑至40.1%，稅後EPS由2024年的6.03元下降至3.01元。半導體客製化零組件業務表現亮眼，受惠於各大晶圓代工與記憶體廠產能利用率維持高

檔，2025年零組件營收成長約20%。

CoPoS為天虹未來最大成長動能：因應AI晶片尺寸持續放大與生產效率的需求，業界正加速CoPoS的發展，天虹已成功開發310mm x 310mm規格的PLP PVD與Descum設備，其PLP PVD已於2026年1月出貨並在OSAT廠進行正背面金屬導線鍍膜的驗證，PLP Descum則是正在天虹廠內進行認證中，CoPoS設備為未來放量最集中、最具潛力的核心動能。

2026年設備營收超越2024年，產品組合優化帶動毛利率回升：(1)預估光電設備營收有望翻倍:受惠光通訊與CPO設備需求強勁，2026年光電設備營收有望翻倍(ALD與PVD設備應用於高精準度光學與絕緣層鍍膜)。(2)EUV光罩保護膜(Pellicle)檢測設備於2Q26驗證測試:天虹開發的EUV光罩保護膜檢測設備正從5W雷射光源的原型機推進至200W光源的第二代量產機型，預估2Q26開始進行驗證測試。(3)半導體零組件業務維持高雙位數強勁成長:零組件與技術服務為天虹最穩定的業務，受惠晶圓廠產能利用率極高帶動耗材需求，以及每年持續開發數十樣客製化新品，預估2026年零組件營收可維持約20%的強勁增長。(4)2026年設備營收超越2024年，2027年設備營收占比過半。綜合上述，受惠半導體零組件跟設備業務強勁動能，預估天虹2026年營收將年增35%至30.3億元，產品組合優化帶動毛利率年增2.9ppts至43.0%，稅後EPS 6.4元。

圖表4：產品類別比重與毛利率趨勢



資料來源：弘塑、玉山投顧整理(2026/04)

產業趨勢

AI加速半導體先進封裝需求，先進封裝為台灣半導體設備商最大成長動能:根據Yole Intelligence預估，2024~2030年先進封裝市場規模會從400億美元成長至800億美元，年複合成長率約10.7%，2.5D/3D封裝是成長最快的技術領域，儘管2025年非AI相關的傳統應用動能疲弱，然受惠於生成式AI與高效能運算(HPC)的強勁需求驅動，先進封裝產能持續處於供不應求的緊繃狀態，台積電與OSAT積極加速擴充先進封裝產能以滿足市場缺口;根據台積電在SEMICON Taiwan 2025研討會中提供的數據，從N28製程演進至A16製程，僅靠製程微縮可提升80倍算力，然而，搭配先進封裝技術可大幅提升320倍，先進封裝已成為決定最終晶片效能的關鍵。

台積電先進封裝產能缺口持續，OSAT陣營受惠外溢效應顯著:台積電2026年資本支出520~560億美元，其中70~80%用在先進製程、10%特殊製程、10~20%先進封裝、測試和光罩、其他，換算先進封裝資本支出為52~112億美元，台積電CoWoS產能2025年底月產能翻倍至每月7~7.5萬片，2026年隨著台南及嘉義新廠產能接續開出，預估台積電CoWoS產能2026年底將達到每月14~15萬片，年增率接近100%，儘管台積電加速產能布建，然而AI晶片需求成長幅度遠超擴產極限，Nvidia與AMD等一線大廠積極扶植其他供應商，因此部分訂單外溢至其他OSAT廠商

如日月光、Amkor，而台積電也策略性地將資源集中於高毛利的CoW製程，預期2026年OSAT廠商在AI高階封裝領域的產能佔比將顯著成長，帶動產品組合優化及獲利能力提升，同時隨著OSAT廠積極建立先進封裝產線，將帶動相關半導體設備供應商的拉貨動能。

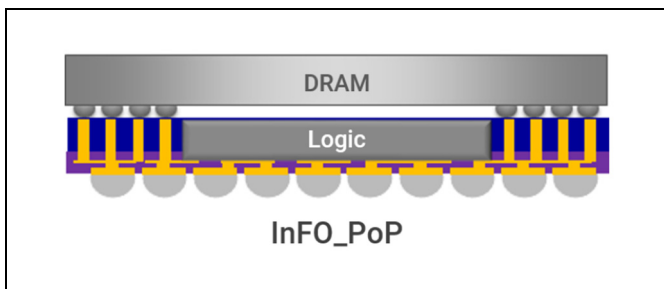
圖表5、CoWoS先進封裝月產能預估表

公司	2024	2025	2026
台積	35~40K	70~75K	140~150K
Amkor	7~8K	10~15K	15~20K
日月光	3~5K	10~15K	20~25K

資料來源：供應鏈調查、玉山投顧整理(2026/04)

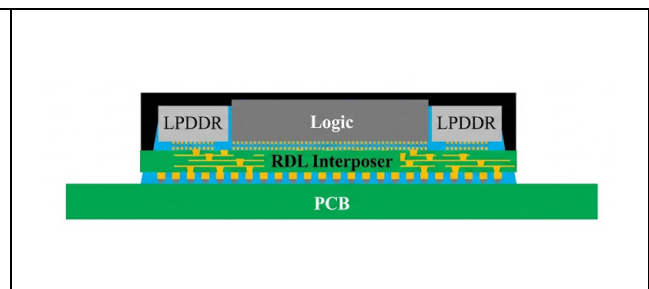
預估WMCM成為未來高階手機與穿戴式裝置的首選方案: WMCM(Wafer-Level Multi-Chip Module)是台積電InFO(Integrated Fan-Out)技術的延伸架構，製程上更接近CoWoS-R，目的在取代既有的InFO-PoP(Package-on-Package)，空間配置由原先堆疊於處理器上方的LPDDR記憶體移至邏輯晶片旁，解決先進製程堆疊造成的散熱瓶頸並進一步降低厚度，維持無載板的設計，可應用於高階手機與穿戴式裝置，目前終端採用客戶為美系手機品牌廠。預估台積電2026年在嘉義廠擴建WMCM產線，2026年底WMCM產能月產能達每月5萬片，主要受惠設備廠為弘塑、辛耘、志聖、均華、鴻勁等等。

圖表6、InFO-PoP示意圖



資料來源：台積電、玉山投顧整理(2026/04)

圖表7、WMCM架構推估示意圖



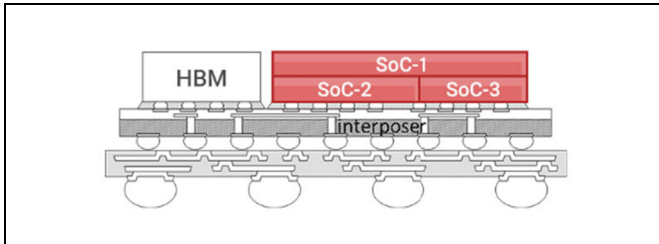
未來SoIC與面板級封裝CoPoS帶動設備規格升級: SoIC(System on Integrated Chips)是台積電的3D堆疊技術，主要利用Hybrid Bonding(混合鍵合)技術實現晶片與晶片之間的垂直堆疊，透過縮短晶片間的傳輸距離，實現超高密度互連，SoIC又分成SoIC-X與SoIC-P，SoIC-X採用銅對銅混合鍵結(Hybrid Bonding)，不需要傳統錫球，大幅縮小晶片接點間距，提供密度更高的連接，SoIC-P採用難度較低的Micro bump，能顯著提升生產良率並降低成本，由於SoIC製程中需要對銅表面進行化學機械研磨 (CMP)，使表面變薄、平坦化，研磨後需要清洗表面，台廠主要受惠設備廠為弘塑跟辛耘。

CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate)是FOPLP (Fan-Out Panel Level Package)技術的高階延伸架構，用方形玻璃作為製程的載具(carrier)來進行扇外型封裝，在經濟效益上，CoPoS面積使用率高達95%(CoWoS則<85%)可有效降低成本並擴大封裝尺寸，群創開發線寬/線距介於2 μ m~10 μ m的中階半導體封裝，適用於PMIC、高功率、射頻通訊、車用等晶片，台積電、日月光、力成則專注於線寬/線距為2/2 μ m的高階封裝，可應用於AI跟HPC晶片。

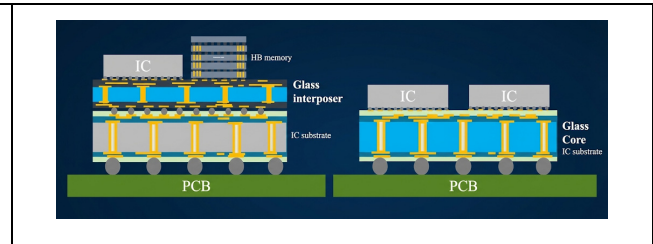
對標CoWoS技術分成CoWoS-S(Silicon interposer)、CoWoS-R(RDL Interposer)與CoWoS-L(LSI)，CoPoS技術也可分成CoPoS-Glass interposer、CoPoS-RDL Interposer、CoPoS-LSI，CoPoS-RDL Interposer&CoPoS-LSI與既有的CoWoS-R&CoWoS-L製程接近，預估台積電會優先研發這兩個技術，2Q26建置研發機台，最快2028年量產，主要受惠者為原有CoWoS設備商弘塑、辛耘、志聖、萬潤等等。Glass interposer則面臨許多挑戰包含(1)有限的佈線

空間:玻璃的核心(Core)僅能透過TGV進行垂直導通，無法像有機材料在內部進行橫向佈線，大部分的訊號互連都必須集中在玻璃表面的RDL層，但是過多的RDL層數會導致應力問題，因此工程師必須在有限的層數內完成高密度的佈線設計。(2)缺乏長期可靠度數據: 玻璃作為半導體封裝的新興材料，缺乏如傳統有機材料般數十年的歷史數據用於建立標準、性能指標和壽命預期，這導致其在對可靠度要求極高的領域(如車用、航太、工業)導入緩慢。(3)微裂紋:玻璃在TGV雷射鑽孔過程中容易在孔壁產生微裂紋，若後續蝕刻製程未妥善消除，這些微裂紋將導致玻璃在後續製程或使用中破裂，因此預估Glass interposer仍需要3~5年去開發。

圖表8、SoIC示意圖



圖表9、Glass interposer& Glass substrate示意圖



資料來源：台積電、Georgia Institute of Technology、玉山投顧整理(2026/04)

圖表 10、季度財測修正

百萬元	更新預估		前次預估		差異(%)	
	25Q4	26Q1	25Q4	26Q1	25Q4	26Q1
營收	722	582	692	550	4.29	5.90
毛利	305	237	284	219	7.32	8.29
營業利益	110	67	100	61	9.53	9.84
稅前淨利	92	87	87	78	5.95	11.56
稅後淨利	71	69	68	65	4.40	6.04
每股盈餘(元)	1.09	1.02	1.02	0.97	6.86	5.15
財務比率(%)						
毛利率	42.29	40.70	41.10	39.80	2.91	2.26
營益率	15.23	11.51	14.50	11.10	5.03	3.72
淨利率	12.80	14.85	12.60	14.10	1.59	5.35

資料來源：玉山投顧(2026/04)

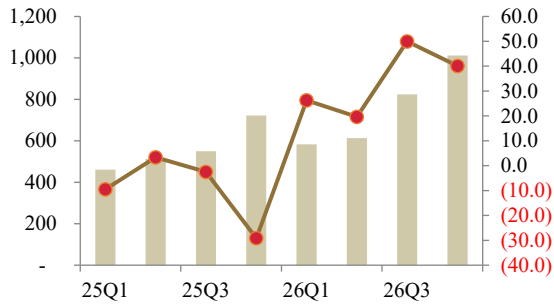
圖表 11、季度財務資訊

百萬元	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	2025	26Q1	26Q2	26Q3	26Q4	2026
營業收入	461	512	549	722	2,245	582	613	824	1,011	3,030
營業毛利	193	201	201	305	900	237	257	360	448	1,302
營業費用	166	170	174	195	706	170	190	215	230	805
營業利益	27	30	26	110	194	67	67	145	218	497
淨業外收支	30	(11)	47	(18)	49	19	12	10	10	51
稅前淨利	57	19	74	92	243	87	79	155	228	548
稅後淨利	48	19	59	71	203	69	63	122	179	433
EPS(元)	0.73	0.28	0.91	1.09	3.01	1.02	0.93	1.81	2.64	6.40
財務比率										
毛利率	41.91	39.21	36.51	42.29	40.09	40.70	41.90	43.70	44.30	42.96
營業利益率	5.92	5.95	4.80	15.23	8.64	11.51	10.90	17.60	21.55	16.39
稅前淨利率	12.46	3.78	13.44	12.80	10.83	14.85	12.89	18.77	22.54	18.09
YoY(%)										
營業收入	(9.53)	3.38	(2.51)	(29.16)	(13.26)	26.29	19.62	49.94	40.11	35.00
營業毛利	(17.01)	(9.33)	(18.49)	(30.17)	(20.89)	22.66	27.84	79.49	46.75	44.65
營業利益	(67.67)	(59.97)	(68.76)	(32.79)	(52.50)	145.72	119.05	450.01	98.29	156.02
稅前淨利	(43.89)	(82.80)	(30.74)	(47.16)	(51.04)	50.52	308.34	109.41	146.73	125.50
稅後淨利	(42.7)	(80.23)	(28.81)	(51.26)	(50.15)	42.76	237.94	107.20	151.67	113.35
QoQ(%)										
營業收入	(54.73)	11.08	7.26	31.33		(19.29)	5.21	34.45	22.72	
營業毛利	(55.78)	3.93	(0.13)	52.16		(22.33)	8.31	40.22	24.41	
營業利益	(83.31)	11.69	(13.48)	316.76		(38.99)	(0.43)	117.24	50.25	
稅前淨利	(67.13)	(66.34)	281.56	25.12		(6.35)	(8.67)	95.67	47.42	
稅後淨利	(66.85)	(61.51)	217.55	20.31		(2.91)	(8.90)	94.70	46.14	

資料來源：玉山投顧(2026/04)

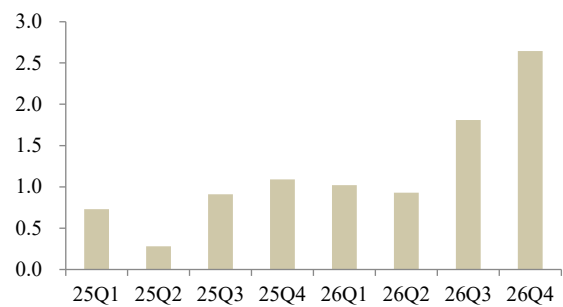
圖表 12、季營收 YoY

(單位：百萬元，%)



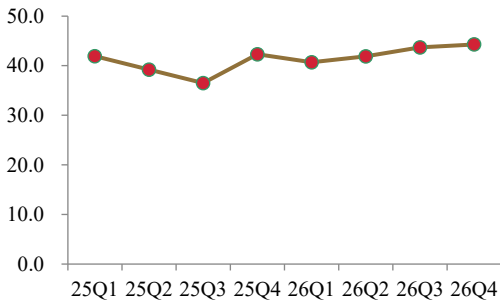
圖表 13、季每股盈餘

(單位：元)



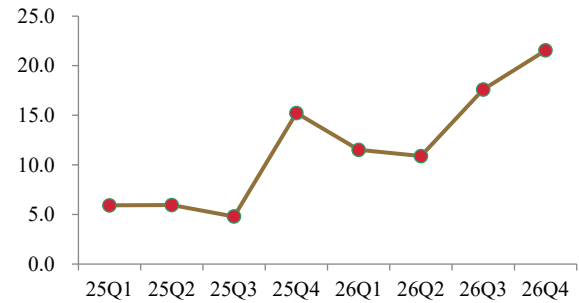
圖表 14、季毛利率

(單位：%)



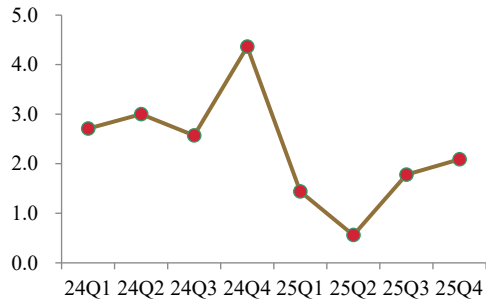
圖表 15、季營業利益率

(單位：%)



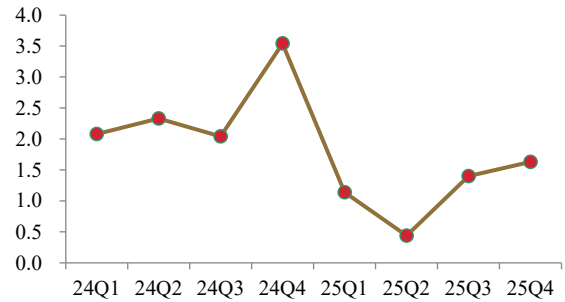
圖表 16、稅後股東權益報酬率

(季未年化)



圖表 17、稅後資產報酬率

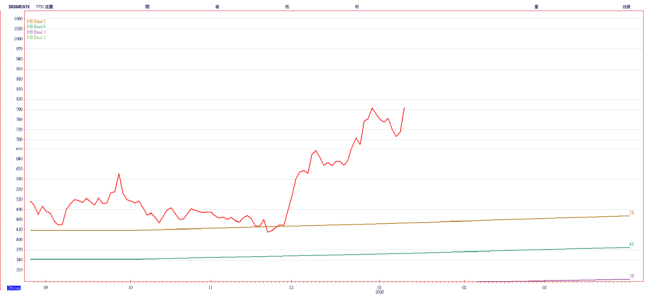
(季未年化)



圖表 18、本益比區間



圖表 19、股價淨值比區間



資料來源：CMoney，玉山投顧(2026/04)

年損益表		單位:百萬元			
	2023	2024	2025	2026(F)	
營業收入	1,993	2,588	2,245	3,030	
營業成本	1,116	1,450	1,345	1,728	
營業毛利	877	1,138	900	1,302	
營業費用	555	729	706	805	
營業利益	323	409	194	497	
營業外收支淨額	42	88	49	51	
稅前淨利	365	496	243	548	
稅後淨利	307	407	203	433	
普通股股本	675	675	676	676	
EPS(元)	5.02	6.03	3.01	6.40	
年成長率					
營收	9.8%	29.9%	-13.3%	35.0%	
營業利益	11.9%	26.6%	-52.5%	156.0%	
稅前淨利	-0.5%	36.2%	-51.0%	125.5%	
母公司稅後淨利	-3.2%	32.7%	-50.2%	113.3%	
獲利能力比率					
毛利率	44.0%	44.0%	40.1%	43.0%	
營業利益率	16.2%	15.8%	8.6%	16.4%	
稅前淨利率	18.3%	19.2%	10.8%	18.1%	
稅後淨利率	15.4%	15.7%	9.0%	14.3%	

資產負債表		單位:百萬元			
	2023	2024	2025	2026(F)	
流動資產	2,927	2,914	3,006	3,245	
現金及約當現金	1,005	441	618	710	
存貨	1,144	1,095	1,524	1,600	
應收帳款及票據	477	876	705	776	
其他流動資產	301	503	159	159	
長期投資	0	0	0	0	
固定資產	1,121	1,228	1,405	1,435	
其他長期資產	102	87	176	177	
資產總額	4,142	4,220	4,577	4,848	
流動負債	592	566	849	960	
應付帳款及票據	222	225	397	477	
短期借款	103	11	111	133	
什項負債	268	330	341	350	
非流動負債	424	239	230	102	
負債總額	1,016	806	1,079	1,062	
普通股股本	675	675	676	676	
資本公積	1,634	1,634	1,663	1,663	
保留盈餘	803	1,074	1,136	1,372	
股東權益總額	3,125	3,415	3,498	3,786	

現金流量表		單位:百萬元			
	2023	2024	2025	2026(F)	
稅前淨利	365	496	243	548	
折舊及攤提費用	72	72	75	75	
本期營運資金變動	-189	-294	-209	67	
其他項目	-203	-49	-72	0	
營運活動之現金流量	45	225	38	690	
資本支出	-499	-84	-99	-105	
本期長期投資變動	0	0	0	0	
其他項目	-208	-258	292	-292	
投資活動之現金流量	-706	-342	193	-397	
短期借款及票券變動	5	-91	88	22	
舉措/償還長期借款	149	-214	-8	-128	
發行/償還公司債	0	0	0	0	
現金增資	1,030	0	0	0	
發行現金股利	-61	-135	-142	-95	
其他項目	0	0	1	0	
融資活動之現金流量	1,113	-452	-54	-201	
匯率影響數	-1	4	0	0	
本期現金流量	451	-565	177	93	
期末現金及約當現金	1,005	441	618	710	

重要財務比率		單位:百萬元			
	2023	2024	2025	2026(F)	
資產品質比率					
負債比率	24.5%	19.1%	23.6%	21.9%	
槓桿比率	32.5%	23.6%	30.9%	28.1%	
流動比率	494.4%	514.5%	354.0%	337.9%	
速動比率	301.2%	321.2%	174.5%	171.3%	
存貨週轉率(次)	1.04	1.30	1.03	1.11	
存貨週轉天數	346.32	277.90	350.61	325.37	
應收帳款週轉率(次)	4.33	3.83	2.84	4.09	
應收帳款週轉天數	83.13	94.11	126.80	87.99	
總資產週轉率(次)	0.48	0.61	0.49	0.63	
淨值週轉率(次)	0.64	0.76	0.64	0.80	
股東權益報酬率	12.3%	12.4%	5.9%	11.9%	
總資產報酬率	8.6%	9.7%	4.6%	9.2%	
OCF/流動負債	7.7%	39.8%	4.4%	71.9%	
每股比率					
每股淨值(元)	46.30	50.59	51.02	56.02	
每股營收(元)	29.53	38.35	33.22	44.84	
每股盈餘(元)	5.02	6.03	3.01	6.40	
每股現金股利(元)	2.10	1.40	1.40	2.90	
現金股利配發率	41.9%	23.2%	46.5%	45.3%	

玉山證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱「玉山投顧」）為玉山金融事業群之成員。

研究報告可自本公司網站(www.esunconsulting.com.tw)取閱。

投資評等說明

買進：未來六個月內潛在漲幅25%以上。
增加持股：未來六個月內潛在漲幅15~25%。
中立：未來六個月內漲跌幅-10~10%。
降低持股：未來六個月內潛在跌幅15%以上。
未評等：無。

研究人員聲明

研究人員聲明無任何其個人報酬來自於本研究報告的建議或觀點。

免責聲明

玉山投顧已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，財務預估及投資評等係就報告發行當時，所收集之資訊進行合理之判斷，日後若有資訊更新，玉山投顧將不針對此報告出具更新通知。本報告僅供投資人參考，玉山投顧不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

智慧財產權聲明

本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬玉山投顧所有。除非獲得玉山投顧事前書面同意外，均不得擅自以任何形式複製、重製、修改、發行、上傳、張貼、傳送、散佈、公開傳播、販售或其他非法使用本資料。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權 貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。

CSR 天下永續公民獎

《天下雜誌》主辦之天下永續公民獎，與世界同步，以公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等指標，評選出台灣最具未來性的新價值企業。為企業接軌國際，訂定競爭力新標準。

邀請過去3年內有2年獲利為正的全台所有企業參加（外商不受獲利限制），並分為大型企業、中堅企業、外商企業、小巨人組4組評選。評選將綜合參賽企業4大構面（公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續）表現，依總分排序取各組應入選家數。2024年新設「非營利事業組」，評選將依據各組織提出之特色專案進行評分。

評選構面：

公司治理：主要衡量董事會的獨立性及資訊揭露透明度

企業承諾：著眼人才培育、幸福職場的打造，及供應鏈提升與對消費者承諾

社會參與：衡量企業是否長期投入特定社會議題、並發揮積極影響力

環境永續：調查企業在環保及能源管理上具有具體目標與作法